

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2026-007

## 苏州东微半导体股份有限公司

### 关于竞得土地使用权暨项目投资进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）按照法定程序参与了苏州市国有建设用地使用权的网上挂牌出让竞拍，以人民币 992.00 万元的价格竞得位于苏州工业园区金鸡湖街道星汉街东、苏虹西路北地块的土地使用权，并签署了《国有建设用地使用权出让合同》和《苏州工业园区投资发展监管协议（工业用地）》。现将具体情况公告如下：

#### 一、项目投资概述

公司分别于 2026 年 3 月 23 日和 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司通过公开竞拍的方式取得位于江苏省苏州市工业园区金鸡湖街道星汉街东、苏虹西路北地块的土地使用权，作为公司“研发生产总部基地建设项目”的建设用地，同时授权公司管理层及其授权代表办理与购买土地使用权及投资项目相关事宜，包括但不限于授予参与土地竞拍决定权，与相关方就项目合作进行协商洽谈，签署相关协议、合同、承诺书及其他必要文件决定权，签订建设施工协议或文件决定权，并办理相关审批、登记等手续。该授权自本次股东会审议通过之日起生效，至上述事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 25 日和 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于拟购买土地使用权并投资建设总部基地的公告》（公告编号：2026-003）、《苏州东微半导体股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-006）。

## 二、项目进展情况

近日，公司按照法定程序参与了苏州市国有建设用地使用权的网上挂牌出让竞拍，以人民币 992 万元的价格竞得位于苏州工业园区金鸡湖街道星汉街东、苏虹西路北地块的土地使用权，并签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：GF-2025-2601）和《苏州工业园区投资发展监管协议（工业用地）》（合同编号：CJ20250604）。

取得土地使用权后，公司将严格按照既定规划，稳步有序推进本项目建设工作。同时，公司将继续聚焦主营业务发展，持续加强研发投入，积极拓展市场空间，不断提升公司产品产能与综合竞争力，保障公司长期健康发展。

## 三、合同的主要内容

（一）《国有建设用地使用权出让合同》的主要内容：

1、合同双方：

出让人：苏州工业园区规划建设委员会

受让人：苏州东微半导体股份有限公司

2、土地简述：土地位于苏州工业园区金鸡湖街道星汉街东、苏虹西路北，总面积为 26,792.31 平方米，建筑总面积不低于 42,867.70 平方米，容积率 $\geq 1.6$ 且 $\leq 3.0$ ，建筑高度 60 米，建筑密度（建筑系数） $\geq 35\%$ 且 $\leq 60\%$ ，绿地率 $\geq 15\%$ ；

3、土地用途：工业用地；

4、出让年限：30 年；

5、出让价款：人民币 992.00 万元；

6、合同的生效：本合同自双方签订之日起生效。

（二）《苏州工业园区投资发展监管协议（工业用地）》主要内容：

1、协议当事人

甲方：苏州工业园区管理委员会

乙方：苏州东微半导体股份有限公司（土地竞得人）

2、地块概况

地块位置：苏州工业园区金鸡湖街道星汉街东、苏虹西路北地块；

土地用途：工业用地；

用地面积：26,792.31 平方米；

出让年期：30 年；

项目总投资额：32,000.00 万元；

产业准入类别：集成电路。

### 3、甲方权利及义务

甲方有权按照本协议约定项目对开工情况、投入使用情况、固定资产总投资或项目总投资完成情况、纳税情况等相关指标进行评估。乙方违反本协议的，甲方有权根据协议约定追究乙方的相应责任，同时有权要求相关部门在政府采购、建设工程招投标、政府资金扶持等方面对乙方进行限制。

### 4、乙方权利及义务

(1)、乙方取得出让宗地只能用于本协议约定的产业用途，不得擅自变更项目内容和用地性质。

(2)、乙方在开发过程中须按本协议约定的要求进行开发建设。

(3)、乙方需在《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起一年内开工，《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起三年内竣工并投入使用。但因政府、政府有关部门或者不可抗力等原因造成不能按期动工开发的，经批准办理延期开工手续的除外。

(4)、在土地使用年限内，乙方不得擅自以任何形式（包括股权转让方式）转让建设用地使用权以及该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施；不得擅自将建设用地使用权以及该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施对外出租（企业控股的子公司、投资关联的上下游产业链公司、持股平台等除外）。

### 5、违约责任

(1)、如乙方存在未能按本协议约定按期开工建设或投入使用的（政府原因除外）、未完成固定资产总投资或项目投资等违反本协议约定的情形，甲方有权要求乙方限期改正，如在限定期限内不予改正或改正不符合要求的，甲方有权移交有关单位收回国有建设用地使用权或解除《国有建设用地使用权出让合同》。

(2)、甲方及相关单位根据约定收回国有建设用地使用权或解除《国有建设用地使用权出让合同》时，乙方同意就其相应的违约情形，作为有关单位收回国有建设用地使用权或解除《国有建设用地使用权出让合同》的依据。甲方及相关单位按照下列方式处理：返还剩余年限土地出让价款（不计息）并移交有关单位

收回地上建筑物、构筑物及其附属设施，按照收回决定时点评估本地块范围内建筑物、构筑物及其附属设施的残余价值，给予乙方相应补偿。

#### 6、适用法律及争议解决

(1)、本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决，适用中华人民共和国法律、法规、规章及江苏省内的相关规定。

(2) 因履行本协议发生争议，由甲、乙双方协商解决；协商不成的，将通过依法向人民法院提起诉讼进行解决。

#### 7、协议的生效和终止

(1)、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

(2)、出让合同约定的使用年期到期前，甲方进行续期评估。乙方未提出续期申请，或提出续期申请但评估后不符合条件的，国有建设用地使用权到期后，本协议终止。

(3)、对其他需综合评估的项目，可另行商议补充协议。

### **四、本次竞得土地使用权对上市公司的影响**

公司本次购买土地使用权并投资建设项目是基于公司战略规划及经营发展的长期需要，本项目目前尚处于筹划阶段，建设周期较长。从长远发展方向来看，若本次投建事项顺利实施，可以有效满足公司对经营场地和项目建设用地的需求，作为公司战略发展用地，打造集研发、办公、仓储于一体的公司总部基地。一方面有利于公司扩大生产经营规模，优化场地资源配置，提升公司管理效能及资源整合能力，提升公司整体形象；另一方面有利于完善公司产业布局，满足公司业务拓展及发展需要，促进公司长期可持续发展。

项目的资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司将根据实际资金情况实施进度进行合理规划调整，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **五、后续事项及相关风险提示**

(一) 公司本次投资建设项目在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。公司会按照相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作。

（二）本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、业务拓展等均存在一定的不确定性，可能存在公司本次投资计划不达预期的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2026年4月24日